

Prensa De Calentamiento Integrada De 24 Toneladas De 200X200Mm Para Preparación De Muestras De Laboratorio

Número de artículo: XP55



Introducción

Prensa de calentamiento integrada profesional con fuerza de sujeción de 24 toneladas y placas calefactoras de 200x200mm, ideal para investigación de baterías, ensayo de materiales y preparación de muestras. El control preciso de temperatura hasta 300°C garantiza resultados fiables y consistentes.

[Aprende más](#)

| Aplicación | Descripción | Beneficio Clave |
|--|--|---|
| Prensado de Electrodo y Electrolitos de Baterías | Consolidación de polvos de cátodo/ánodo y formación de pastillas de electrolito de estado sólido para iones de litio y celdas de baterías de próxima generación. | La distribución uniforme de densidad evita puntos calientes y garantiza una conductividad iónica consistente en toda la pastilla. |
| Embossing y Laminación de Películas de Polímero | Unión térmica de películas de polímero multicapa, sellado de chips microfluídicos y texturizado superficial para dispositivos de laboratorio en un chip. | El control preciso de temperatura y presión conserva nanoestructuras delicadas sin degradación térmica. |
| Preparación de Pastillas para FTIR y XRF | Producción de pastillas transparentes de KBr para espectroscopía infrarroja y cuentas fundidas para análisis de fluorescencia de rayos X. | Elimina inclusiones de aire y variaciones de espesor, proporcionando líneas base espectrales reproducibles. |
| Desarrollo de Materiales Compuestos | Prensado en caliente de compuestos de matriz metálica, polímeros reforzados con cerámica y consolidación de preimpregnados de fibra de carbono. | Maximiza la impregnación de fibras y la eliminación de huecos bajo perfiles controlados de calor y presión. |
| Producción Piloto de Comprimidos Farmacéuticos | Compresión de lotes pequeños de mezclas de polvo en comprimidos para ensayos de formulación y estudios de estabilidad. | El registro completo de parámetros de prensado facilita la documentación y los estudios de escalado para FDA/EMA. |
| Sinterización en Metalurgia de Polvos | Precompactación de polvos metálicos y cerámicos a temperaturas elevadas antes de la sinterización final. | Aumenta la densidad verde y reduce la contracción por sinterización, mejorando la precisión de forma neta. |
| Unión de Obleas de Semiconductores | Unión por compresión térmica de obleas de silicio o ensamblajes chip-on-flex mediante fuerza y temperatura controladas. | Logra líneas de unión uniformes sin huecos, un aspecto crítico para la fabricación de sistemas microelectromecánicos (MEMS). |

| Parámetro | XP55 |
|------------------------------------|--|
| Modelo | XP55 |
| Capacidad de Prensa | 0 - 24 toneladas |
| Temperatura de Trabajo de Placas | Ambiente - 300 °C |
| Potencia de Calentamiento (Total) | 1200 W (2 x 600 W) |
| Dimensiones de Placas | 200 x 200 mm |
| Refrigeración de Placas | Circulación de agua integrada |
| Control de Temperatura | PID de doble zona con estabilidad de ±2 °C |
| Visualización y Control | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas, programable |
| Fuente de Alimentación | 220 V, 50 Hz, monofásica |
| Dimensiones Totales (An x Pr x Al) | 950 x 260 x 525 mm |

| | |
|-----------|--------|
| Parámetro | XP55 |
| Peso Neto | 180 kg |